

Lotbarren S-Sn99Ag0,3Cu0,7/bleifrei

Artikel Gruppe 283

Lotbarren S-Sn99Ag0,3Cu0,7

Allgemeine Beschreibung

Lote wurden entwickelt, um herkömmliche Zinn/ Blei- Legierungen durch bleifreie Lote in bestehenden Produktionsprozessen der Elektronikfertigung zu setzen und die Eigenschaften der bleifreien Lote durch Mikrolegierungs-zusätze zu verbessern.

Anwendung

Bei der Umstellung von bleihaltigen auf bleifreie Prozesse sind Anpassungen der Temperaturprofile an den Lötanlagen erforderlich. Die Löttemperaturen von SnAgCu Loten liegen im Bereich von 255- 280°C. Die Qualität der resultierenden Lötstellen ist vergleichbar mit herkömmlichen Sn/Pb Loten. Die physikalischen Eigenschaften der Legierungen werden durch die Mikrolegierungszusätze nicht verändert. Vorteile:

- Feinkörnigere, glattere und glänzendere Oberflächen, bedingt durch das veränderte Erstarrungsverhalten.
- Verminderte Ablegierung von Kupfer
- Verlängerte Standzeit von Lotbädern durch reduzierte Kupferanreicherung
- Reduzierter Angriff auf Lottiegel und Lötwerkzeug

Physikalische Eigenschaften

Zusammensetzung	Schmelzpunkt bzw. Schmelzbereich [°C]	Dichte [g/cm ³]
Sn99Ag0,3Cu0,7	217- 227	7,33

Die Legierungen entsprechen hinsichtlich der Reinheit den Anforderungen der Norm IEC 61190-1-3 Bzw. DIN EN 29453 / ISO 9453.

Das Material ist mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig, sollte jedoch in sauberer und trockener Umgebung gelagert werden. Eine Verwendung über diesen Zeitraum hinaus ist in vielen Fällen problemlos möglich, sollte jedoch durch entsprechende Versuche bestätigt werden.